

Pressemitteilung

10/09/2009

AT&S und Häusermann schließen Technologiekooperation und bündeln ihre Kompetenzen im Bereich Hochstrom- und Thermalmanagement

AT&S, Europas größter Leiterplattenproduzent und technologischer Vorreiter im Bereich Thermalmanagement, erweitert ihr Produktportfolio um die von Häusermann entwickelte Technologie HSMtec, die Hochstromfähigkeit und Thermalmanagement in einer Technologie vereint. Im Rahmen der Kooperation bringt AT&S vor allem ihre langjährige Erfahrung und Kompetenz in der Fertigung größerer Serien am Standort Leoben-Hinterberg ein.

„Der steigende Bedarf an effizienter Wärmeableitung in der Leiterplattenproduktion, kombiniert mit Feinstleiter- und Steuerelektronik, wie er z.B. bei High-Power-LEDs zum Tragen kommt, hat uns dazu bewogen, die innovative Technologie HSMtec in unser Portfolio zu integrieren“, erläutert Heinz Moitzi, Technikvorstand der AT&S, die Kooperation mit Häusermann. Mit ihrer langjährigen Erfahrung, dem Know-how in der Fertigung größerer Serien sowie technologischen Vorreiterrolle erwies sich AT&S als idealer Kooperationspartner für Häusermann, um die innovative HSMtec-Technologie auch in größeren Volumina anzubieten. Die Realisierung des neuen Verfahrens erfolgt am AT&S Standort Leoben-Hinterberg.

Bei der serienreifen Technologie HSMtec werden externe Kupferteile mittels Bonding-Verfahren direkt auf das Basis Kupfer aufgetragen. Dies erfolgt nach den Design-Vorgaben des Kunden selektiv an jenen Stellen der Leiterplatte, wo hohe elektrische Ströme fließen bzw. Wärme entsteht. Die von Häusermann patentierte und qualifizierte Technologie setzt auf Standard-FR4 Material und gewährleistet damit eine ideale Weiterverarbeitbarkeit. Der wesentliche Vorteil der Technologie besteht in der Übertragung elektrischer Ströme bis zu 400A in Kombination mit Feinstleitertechnik auf einer Leiterplatte. Durch den Wegfall breiter Kupferbahnen wird Platz eingespart bzw. mehr Funktionalität auf gleicher Fläche ermöglicht. Eine mehrdimensionale Ausführung der Leiterplatte wird mittels Tiefenfräsungen verwirklicht. Durch die punktuelle Bearbeitbarkeit und den neuartigen Prozess kann die Produktion zudem schneller und kostengünstiger realisiert werden. HSMtec ist nach DIN EN 60068-2-14 und JEDEC A 101-A qualifiziert.

Über AT&S

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der leistungsstärksten Leiterplattenproduzenten. Insbesondere im höchsten Technologiesegment, den HDI Microvia Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit drei Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul). Weitere Infos auch unter www.ats.net.

Über Häusermann

Die Häusermann GmbH ist Spezialist für Leiterplatten mit besonderen Verlässlichkeitsanforderungen im Bereich kleiner und mittlerer Serien. Neben bewährten Technologien, wie Durchkontaktierten-, Multilayer-, HDI-, und Starrflexiblen Leiterplatten bietet Häusermann auch innovative Lösungen vor allem im Bereich Hochstrom- und Wärmemanagement sowie Folientastaturen. Flexibles Eingehen auf Anforderungen und individuelle technische Beratung machen Häusermann zum starken Partner für Unternehmen aus der Industrie-Elektronik, der Steuerung- Mess- und Regeltechnik, EMS (Electronic Manufacturer Services) sowie Medizintechnik, Telekom und der Unterhaltungselektronik. Weitere Infos auch unter www.haeusermann.at.

Presserückfragen:

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Hans Lang, Head of IR & Communication
+43 (0) 1 68 300-9259, h.lang@ats.net, www.ats.net